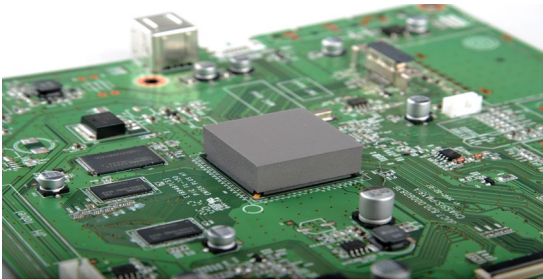


高导热硅胶垫片

TP1200-H65-9是一款12.0W/(m·K)的高导热性能的材料，表面弱粘性，适用于大功率发热元器件的导热散热系统，可用于填充小缝隙和不均匀表面，满足UL 94 V-0的阻燃等级要求。



特性和优点

- 导热系数: 12.0W/(m·K)
- 高导热
- 低渗油
- 高电气绝缘
- 低压缩应力

典型应用

- 电压调节模块 (VRMs)
- ASICs和DSPs
- 高导热需求模块
- 高热量BGAs
- CD ROM/DVD ROM
- 网络通信设备

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	灰色	目视
厚度(mm)	0.5~5.0	ASTM D374
密度(g/cc)	3.3	ASTM D792
硬度(Shore 00)	65	ASTM D2240
渗油率(%)	<0.5	滤纸吸附@压缩25%,125°C,48H
耐温范围(°C)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
存储保质期(月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	>5.0	ASTM D149
介电常数(@1MHz)	7.0	ASTM D150
体积电阻率(Ω·cm)	10 ¹²	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	12.0	ISO 22007-2
热阻(°C·in ² /W @50psi)	T=1.0mm	ASTM D5470
	T=2.0mm	
	T=3.0mm	